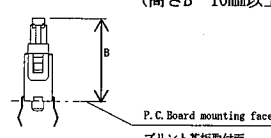
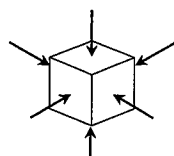
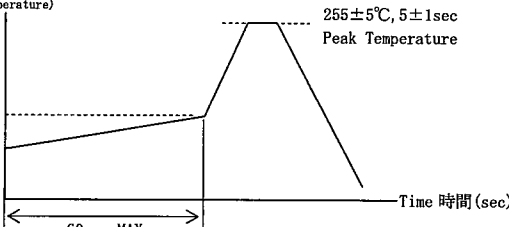


DOCUMENT No. S P P B - S - 6 9 9		TITLE P R O D U C T S P E C I F I C A T I O N S 製 品 仕 様 書		PAGE 2 / 7
5. Mechanical specification 機械的性能				
	Items 項 目	Test conditions 試 験 条 件	Criteria 判 定 基 準	
5.1	Operating force 作 動 力	A static load shall be applied to the actuator in operating direction. 操作部の作動方向へ静荷重を加えて測定する。	Refer to individual product drawing. 個別製品図による。	
5.2	Robustness of terminal 端 子 強 度	A static load of <u>3 N</u> shall be applied to the tip of terminal in a desired direction for 30 s. The test shall be done once per terminal. 端子先端の一方へ <u>3 N</u> の静荷重を30秒間加える。 ただし、回数は1端子当たり1回とする。	Shall be free from terminal looseness damage and breakage of terminal holding portion. Terminals may be bent after test. Electrical performance requirement specified in item 4 shall be satisfied. 端子の脱落、破損及び端子保持部の破損のないこと。ただし、端子の曲がりは差し支えないものとする。また、試験後 4項の電気的性能を満足すること。	
5.3	Robustness of actuator 操 作 部 強 度	A static load of <u>10 N</u> shall be applied in the operating direction of actuator for 15 s. 操作部の作動方向に <u>10 N</u> の静荷重を15秒間加える。 A static load of <u>3 N</u> shall be applied in the pull direction of actuator for 15 s. 操作部の引張方向に <u>3 N</u> の静荷重を15秒間加える。 A static load of <u>3 N</u> shall be applied in the perpendicular direction of operation at the tip of actuator for 15 s. 操作部の先端に作動方向と直角に <u>3 N</u> の静荷重を15秒間加える。	Shall be free from pronounced wobble deformation and mechanical abnormalities. 著しいガタ及び曲がりのないこと。 また、機械的に異常のないこと。	
5.4	Wobble of actuator 操 作 部 の 振 れ	Run-out (P-P) shall be measured by applying a static load of <u>0.5N</u> in the perpendicular direction of operation at the tip of actuator. 操作部の先端に作動方向と直角に <u>0.5N</u> の静荷重を加え振れ幅(最大値)を測定する。	P-P : <u>1 mm</u> MAX P-P : <u>1.8 mm</u> MAX (Height B is 10 mm or more) (高さB 10mm以上)  P.C. Board mounting face プリント基板取付面	
5.5	Vibration 耐 振 性	Switch shall be secured to a testing machine by a normal mounting device and method. Switch shall be measured after following test. スイッチを正規の取付用具、取付方法で試験機に固定し、下記条件で試験を行い、試験後測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲 : 10~55 Hz (2)Total amplitude 全振幅 : 1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合 : 10~55-10 Hz Approx. 1 min 約1分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or linear 対数又は直線近似 掃引振動数の変化方法 (5)Direction of vibration: Three perpendicular directions including actuator 振動の方向 操作部を含む垂直3方向 (6)Duration 振動時間 : 2 h each (6 h in total) 各 2時間 (計 6時間)	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>1 Ω</u> MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>100 MΩ</u> MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100 V</u> AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。	
5.6	Shock 耐 衝 撃 性	Switch shall be measured after following test. 下記条件で試験を行い、試験後測定する。 (1)Mounting method 取付方法 : Normal mounting method 正規の方法で取り付ける。 (2)Acceleration 加速度 : 490 m/s ² (3)Duration 作用時間 : 11 ms (4)Test direction 試験方向 : 6 directions 6 面 (5)Number of shocks 試験回数 : 3 times per direction (18 times in total) 各方向各3回 (計18回) 	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>1 Ω</u> MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>100 MΩ</u> MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100 V</u> AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 Shall be free from mechanical abnormalities. 機械的に異常がないこと。	

DOCUMENT No. SPPB-S-699		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3 / 7
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
5.7	Solderability はんだ付け性	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1) Solder はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu (2) Flux フラックス: Rosin flux (JIS K 5902) having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in 2-propanol (JIS K 8839) solution. ロジン(JIS K 5902)の2-プロパノール(JIS K 8839)溶液とし、濃度は質量比ロジン約25%とする。 (3) Soldering temperature はんだ温度: 245±5℃ Immersing time 浸漬時間: 5±1 s Flux immersing time shall be 5~10 s in normal room temperature. ただし、フラックス浸漬は常温で5~10秒とする。 (4) Immersion depth: Immersion depth shall be at copper plating portion for P.C.Board terminal after mounting. 浸漬深さ Thickness of P.C.Board: 1.6 mm Immersion depth shall be at wiring portion of lead wire for lead wire terminal. プリント基板用端子はプリント基板(t1.6)実装後、銅箔面まで浸漬。リード配線用端子は端子のリード線からげ部を浸漬。	More than <u>90</u> % of immersed part shall be covered with solder. (Frame leg portion should be 75% min.) 浸漬した部分の <u>90</u> %以上がはんだで覆われていること。 (ただし、枠足は75%以上とする。)	
5.8	Resistance to soldering heat はんだ耐熱性	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1) Solder Free 鉛フリーはんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu (2) Flux フラックス: Rosin flux (JIS K 5902) having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in 2-propanol (JIS K 8839) solution. ロジン(JIS K 5902)の2-プロパノール(JIS K 8839)溶液とし、濃度は質量比ロジン約25%とする。 <u>Flow soldering フローはんだの場合</u> Temperature 温度(℃) (Terminal temperature)  Immersion depth: Immersion depth shall be at copper plating portion for P.C.Board terminal after mounting. 浸漬深さ Thickness of P.C.Board: 1.6 mm プリント基板用端子はプリント基板(t1.6)実装後、銅箔面まで浸漬。 Test board shall be 1.6 mm thick. Base material shall be glass fabric base epoxy resin. (Single sided copper clad.) 試験用基板は、板厚 1.6 mm、片面銅張りガラス布基材エポキシ樹脂とする。 <u>Manual soldering 手はんだの場合</u> Wattage of soldering iron こて容量: 50 W Diameter of soldering iron tip こて先径: φ1 mm Temperature of soldering iron tip こて先温度: 350±10℃ Soldering time はんだ付け時間: 3 +1/0_s Above conditions shall be applied to Glass fabric base, epoxy resin P.C.Board of 1.6 mm thick. Soldering iron shall be put at the tip of terminals and prevented excessive force to the terminals. 上記の条件は、t1.6 mm のガラス基材エポキシ樹脂積層板について適用する。 また、はんだごては端子先端に当て、端子に異常加圧のないこと。	No abnormalities shall be observed in appearance and operation. The electrical performance requirements specified in item 4 shall be satisfied. 外観に著しい変形のないこと。 また、動作に異常がなく、4項の電気的性能を満足すること。	
5.9	Resistance to Flux 耐フラックス性	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1) Equipment 装置: Auto-dip chamber オートディップ槽 (2) Solder Free 鉛フリーはんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu (3) Flux フラックス: Rosin flux (JIS K 5902) having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in 2-propanol (JIS K 8839) solution. ロジン(JIS K 5902)の2-プロパノール(JIS K 8839)溶液とし、濃度は質量比ロジン約25%とする。 (4) Soldering temperature はんだ温度: 255±5℃ (5) Immersing time 浸漬時間: 5±1 s (6) Immersion depth: Immersion depth shall be at copper plating portion for P.C.Board terminal after mounting. 浸漬深さ Thickness of P.C.Board: 1.6 mm プリント基板用端子はプリント基板(t1.6)実装後、銅箔面まで浸漬。	Flux shall not be risen up to contact. Shall be free from abnormalities in Operation. 接点部までフラックス上がらないこと。 また、動作に異常がないこと。	

DOCUMENT No. SPPB-S-699		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 4 / 7
6. Durability 耐久性能				
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
6.1	Operating life without load 無負荷寿命	Switch shall be full stroke operated <u>50,000</u> cycles at 15~20 cycles/min without load. 無負荷にて <u>50,000</u> サイクル(動作速度15~20サイクル/分)全移動量位置まで押し込んで連続動作を行う。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>2</u> Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>10</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	
6.2	Operating life with load 負荷寿命	(1)Switch shall be full stroke operated <u>50,000</u> cycles at 15~20 cycles/min with <u>30</u> V DC <u>0.1</u> A. (Resistive load) DC <u>30</u> V, <u>0.1</u> A (抵抗負荷)にて <u>50,000</u> サイクル(動作速度15~20サイクル/分)全移動量位置まで押し込んで連続動作を行う。 (2)Switch shall be full stroke operated <u>50,000</u> cycles at 15~20 cycles/min with <u>3</u> V DC <u>50</u> μA. (Resistive load) DC <u>3</u> V, <u>50</u> μA (抵抗負荷)にて <u>50,000</u> サイクル(動作速度15~20サイクル/分)全移動量位置まで押し込んで連続動作を行う。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>2</u> Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>10</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	
6.3	Operating life with load (High temperature・Low temperature) 負荷寿命 (高温・低温)	Switch shall be full stroke operated <u>5,000</u> cycles at 15~20 cycles/min with <u>30</u> V DC <u>0.1</u> A (Resistive load) at 85±2℃, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1h, and then measurement shall be made within 1h. 85±2℃ DC <u>30</u> V, <u>0.1</u> A (抵抗負荷)にて <u>5,000</u> サイクル(動作速度15~20サイクル/分)全移動量位置まで押し込んで連続動作を行い、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。 Switch shall be full stroke operated <u>5,000</u> cycles at 15~20 cycles/min with <u>30</u> V DC <u>0.1</u> A (Resistive load) at -40±2℃, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1h, and then measurement shall be made within 1h. Water drops shall be removed. -40±2℃ DC <u>30</u> V, <u>0.1</u> A (抵抗負荷)にて <u>5,000</u> サイクル(動作速度15~20サイクル/分)全移動量位置まで押し込んで連続動作を行い、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>2</u> Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>10</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within +30 % of specified value. 規格値の +30 % 以内。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	
7. Environmental test 耐候性				
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
7.1	Cold 耐寒性	After testing at -40±2℃ for 96 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. -40±2℃にて96時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。 ただし、水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>2</u> Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>10</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	
7.2	Dry heat 耐熱性	After testing at 85±2℃ for 96 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2℃にて96時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : <u>2</u> Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : <u>10</u> MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply <u>100</u> V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	

DOCUMENT No. SPPB-S-699		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 5 / 7
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
7.3	Damp heat 耐湿性	After testing at 40±2℃ and 90～95%RH for 96 h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 40±2℃、相対湿度90～95%にて96時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : 2 Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : 10 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply 100 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	
7.4	Salt mist 塩水噴霧	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後確認する。 (1) Temperature 温度 : 35±2℃ (2) Salt solution 塩水濃度 : 5±1% (Solids by mass) (質量比) (3) Duration 試験時間 : 48 ±1 h After the test, salt deposit shall be removed in running water. 試験後試料に付着した塩堆積物を流水で落とす。	No remarkable corrosion shall be recognized in metal part. 機能上有害な著しいさびがないこと。	
7.5	Change of temperature 温度サイクル	After 5 cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that. Water drops shall be removed. 下記条件で5サイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。 ただし、水滴は取り除く。 85±2℃ Normal room Temperature 常温 -40±2℃ 30min 2～3min 30min 2～3min 1 cycle	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1) : 2 Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 4.2) : 10 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3) : Apply 100 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1) : Within specified value. 規格値内とする。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。	
7.6	Damp heat with load (Resistance to silver migration) 耐湿負荷 (耐銀マイグレーション特性)	DC voltage 1.5 times as much as rated voltage shall be applied continuously between adjacent terminals at 60±2℃ and 90～95%RH. After 500 h testing, switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that. Water drops shall be removed. 60±2℃、相対湿度90～95%にて隣接端子間に定格電圧の1.5倍の直流電圧を連続印加し、500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。 ただし、水滴は取り除く。	Insulation resistance 絶縁抵抗 (50V DC) : 10 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 : Apply 100V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. AC 100V、1分間印加。 絶縁破壊のないこと。	

DOCUMENT No. S P P B - S - 6 9 9	TITLE P R O D U C T S P E C I F I C A T I O N S 製 品 仕 様 書	PAGE 6 / 7
【Precaution in use】 ご使用上の注意 A. General 一般項目 A1. This product has been designed and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of conformity or check on us for the details. It is prohibited to use this product for flight control purposes in avionics applications. 本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。 航空機器の運航に関わる部分へは使用にならないでください。 A2. It is necessary to design circuits or software that are not affected by the bounce and chattering specified for each product. スイッチの機種毎に規定されたバウンスやチャタリングで、セットが誤動作しない回路設計（ソフト設定）をしていただきますようご注意ください。 A3. Do not operate switches continuously at extremes of high and low temperatures of the specified temperature range. The maximum operating duration under the specific environmental conditions is specified in the part specifications. 使用温度範囲の上限付近及び下限付近での長時間の連続使用は出来ませんのでご注意ください。使用条件の規定は製品仕様書の各種環境試験の範囲内となりますのでご注意ください。 A4. The specified operation life is determined at the temperature between 5°C and 35°C, not at temperature extremes. 動作寿命の規定は、常温（5～35℃）によるもので使用温度上限及び下限付近での連続動作は出来ませんのでご注意ください。 A5. When switches are to be operated at temperature extremes continuously, we need to examine each specification whether it is possible. 使用温度上限及び下限付近で連続動作を行う場合は、機種毎に仕様規定が可能かどうかの確認が必要となりますのでご注意ください。 A6. For automotive applications, select switches from "Automotive Electronics Use" or "Automotive Electronic Product Line" in the catalog. Do not use other switches. 車載用途には、車載用として指定されたスイッチをご使用下さい、車載用と指定していないスイッチをご使用しないようご注意ください。 A7. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand. 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷（誘導性負荷（L）、容量性負荷（C））で使用される場合は、別途ご相談ください。 B. Soldering and assemble to P.C.Board process はんだ付、基板実装工程 B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意ください。 B2. Condition of soldering shall be confirmed with actual production conditions. はんだの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いいたします。 B3. If you use a through-hole PCB with smaller thickness than recommended, please previously check the soldering conditions adequately, because there is larger heat stress. スルーホールプリント基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は、推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくなりますので半田付け条件については事前に十分な確認をして下さい。 B4. If you use a PCB with smaller thickness than recommended pay enough attention to rising of switches when mounted. 推奨板厚より薄い基板をご使用の際は、実装時のスイッチ浮きに十分ご注意ください。 B5. Use of water-soluble soldering flux shall be avoided because it may cause corrosion of the switch. はんだ付けの際、水溶性フラックスはスイッチを腐食させるおそれがありますのでご使用はお避け下さい。 B6. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. はんだ付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないで下さい。 C. Mechanism design (switch layout) 機構設計 C1. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the actuator) スイッチ操作部に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損場合があります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらないようご注意ください。 (操作部強度参照) C2. Designing printed pattern and parts layout shall be considered because the characteristics may change due to warp of P.C.Board. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。 C3. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall conform to the recommended dimensions in the engineering drawings or Product Catalogs. プリント基板取付穴およびパターンは、製品図又はカタログに記載されている推奨寸法をご使用下さい。 C4. Care should be taken to assure that excess force is not applied on the side of the actuator because it is small and weak when P.C.Board are stacked or transported. 操作部は小さいため強度が弱くなっておりますので、工程内のP.C.Boardの重ねや搬送時、操作部に横方向から力が加わらないようご注意ください。 C5. Do not use return force of switches as operating force. スイッチの復帰力をセットのメカ部の駆動力として利用したご使用はできませんのでご注意ください。 C6. For push type switches, the actuator operating angle shall be within $\pm 5^\circ$ from the free position of the actuator, unless otherwise specified in the part specifications. プッシュタイプスイッチの動作は、特に規定がない限り動作方向に対して$\pm 5^\circ$以内で行うようご注意ください。 C7. Operate switches with full travel as much as possible. 押し込み移動量は出来るだけ全移動量に近い位置でご利用していただくようご注意ください。 C8. Operate switches with sufficient actuator travel after "ON" position. ON開始移動量位置から十分余裕をとった移動量位置でご利用していただくようご注意ください。 C9. Switch shall be used within the specified environmental conditions (Heat, Cold, Humidity and Temperature cycling), when the switches are used in depressed position. 常時ON（押した状態）でご利用される場合については、製品仕様書内の耐候性の項目（耐熱、耐寒、耐湿、温度サイクル）の条件内にてご使用下さい。 C10. Note that the pattern or resist form on the switch mounting surface of the P.C.B. may have an effect on the soldering because of those thickness. スイッチの取付面にあたるプリント基板のパターンやレジストの形状により、その厚み分が半田付け性に影響する場合がありますのでご注意ください。		

DOCUMENT No. SPPB-S-699	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 7 / 7
----------------------------	--	---------------

D. Using environment 使用環境

D1. Foreign matter invaded from outside. 外部侵入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment.
当スイッチは完全密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust.

The followings are examples of dust invasion:

ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意ください。

以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

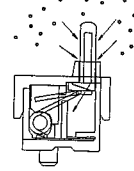
- ① Debris from the cut or hole of P.C. Board in process, or wastes from the P.C. Board protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch.

工程内におけるP.C. Board切断面や穴から発生するクズやP.C. Board保護材（新聞紙、発泡スチロール等）から出るゴミがスイッチに侵入した。

- ② Flux or powdered flux produced by stacking P.C. Board's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

Dusty environment 塵埃環境



"→" Indicates the route of invasion.

"→" は侵入経路を示します。

D2. If you use this product in one of the following environmental conditions, progress of sulfuration and oxidization on the contact part will be accelerated, which may cause contact failure. Therefore, be careful about the supposed environment.

以下の様な環境下で使用されますと、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので使用環境に十分にご注意下さい。

- (1) Around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated. And in case this product is always used in a place where exhaust gas from automobiles exist.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や、自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合

- (2) Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下のような部材に関しましては以下の点にご注意願います。

• For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用して下さい。

• When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.

シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとスイッチ接点部に二酸化珪素の皮膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

E. Storage method. 保管方法

- E1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用下さい。

- E2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリ袋で外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

- E3. Do not stack too many switches for strafe.

過剰な積み重ねは行わないで下さい。

F. Others. その他

- F1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order.

本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又は発注の無い場合は、無効とさせていただきます。

- F2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own direction.

電氣的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめご了承下さい。

- F3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current.

定格を超えての使用は火災発生の恐れがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。

- F4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

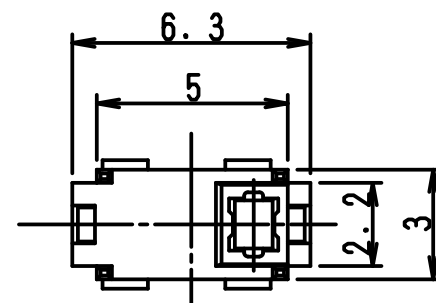
本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"（遅燃性グレード）相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。

- F5. It is recommended to install a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the equipment requiring expensive safety, whatever purposes the equipment is applied for.

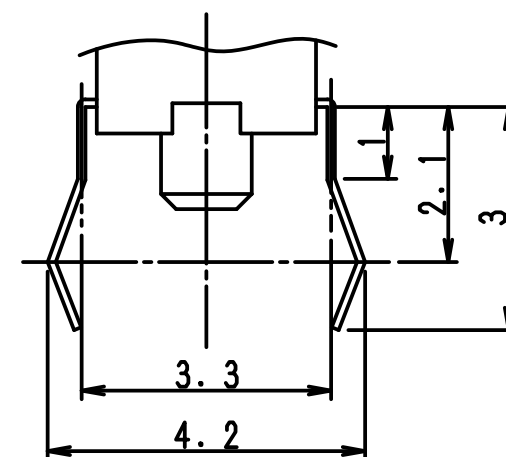
用途の如何にかかわらず、高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図られると同時に、お得意先において安全性のテストをされることをお勧めします。

- F6. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring special safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing that fail-safe design, i.e. a protection network.

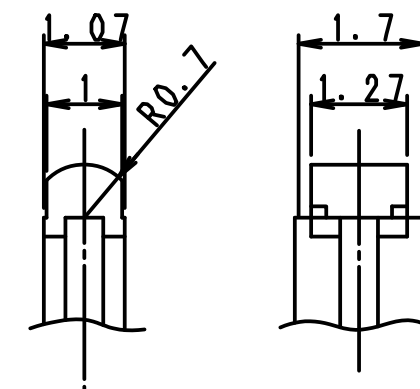
スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンが発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようお願いいたします。



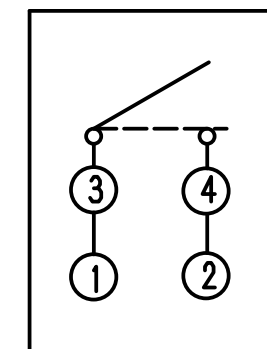
DETAIL B (10:1)



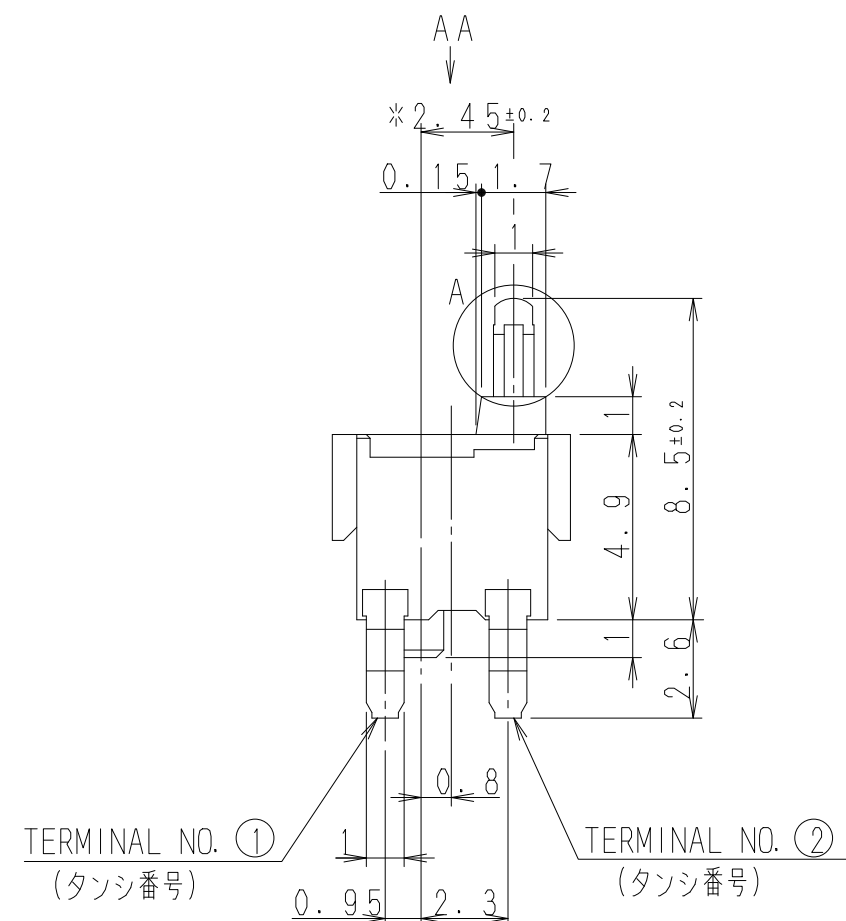
DETAIL A (10:1)



CIRCUIT DIAGRAM
(回路図)

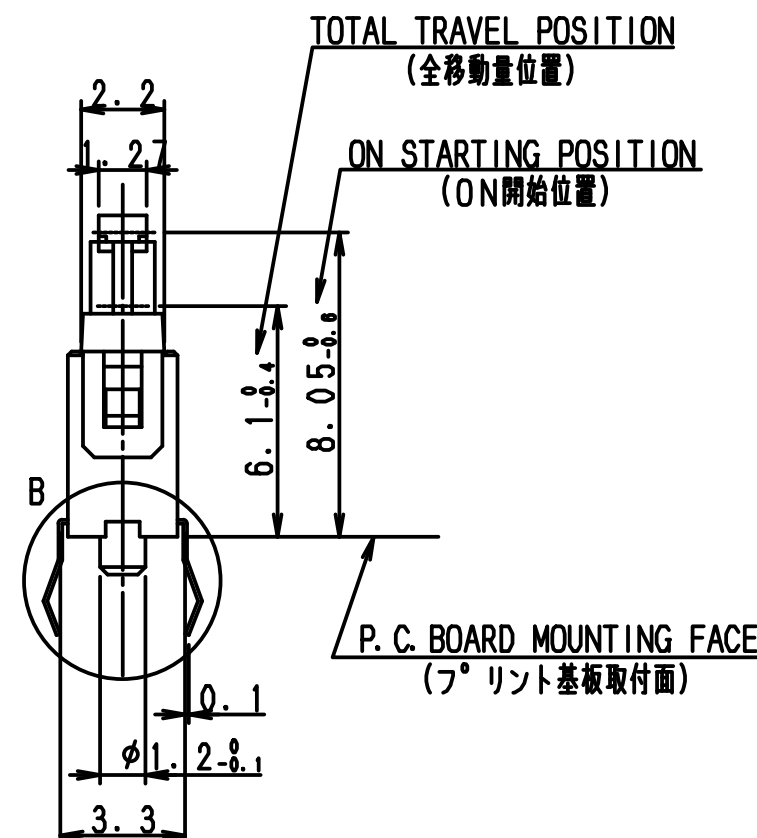


SEE DIRECTION "AA"
(AA方向より見る)

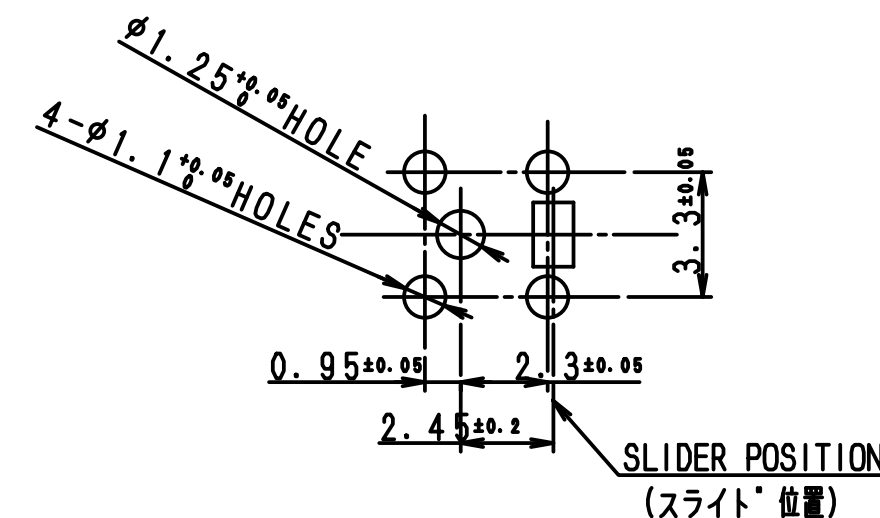


TOTAL TRAVEL POSITION
(全移動量位置)

ON STARTING POSITION
(ON開始位置)



REFERENCE DRAWING FOR MOUNTING HOLES (5:1)
取付穴参考図 (5:1)



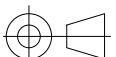
2. DIMENSION * DOES NOT INCLUDE A DEFLECTION OF SLIDER.

(*部の寸法はスライツ' カ' タを含まない.)

1. OPERATING FORCE SHOULD BE LESS THAN
0.35N{36gf} AT TOTAL TRAVEL POSITION

(作動力は全移動量位置で0.35N{36gf}以下とする.)

NOTES
(注記)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.															
BASIC DIMENSIONS		TOLERANCES								UNIT	SCALE	MODEL NO. (製品番号)			
UP TO 4		±0.2						mm		1/2	SPPB512300				
OVER 4 UP TO 16		±0.3													
OVER 16 UP TO 63		±0.4								APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE		
ABOVE 63 TO 250		±0.5								Apr. 16, 1998	Apr. 16, 1998	Apr. 16, 1998	PRODUCT DRAWING (製品図)		
ABOVE 250		±0.7								H.	M.	S.	DOCUMENT NO.		
ANGULAR DIMENSIONS ±3°			ZONE	SYMB	DATE		APPD	CHKD	DSGD	Yoshizawa	Kise	Chiba	SPPB512300, AE11, 003		
										= 1/5			FURUKAWA DIV. (A3)		